

证券代码：300689

证券简称：澄天伟业

编号：2025-003

深圳市澄天伟业科技股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称及人员姓名	红思客资产、山西证券、中金财富、国投证券、国投期货、远东宏信、北斗星投资、哲灵投资、雷沃基金、慧研智投、骏胜投资、太古投资、香港星悦资本、深圳宝林泉科技发展有限公司
时间	2025 年 5 月 29 日
地点	深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 34 楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事：宋嘉斌 董事会秘书、财务总监：蒋伟红 证券事务代表：陈远紫
投资者关系活动主要内容介绍	一、公司介绍公司基本情况和发展历程。 二、与调研机构的互动交流。 公司与调研机构方互动交流的主要内容如下： 1、请问智能卡行业市场容量、增长空间如何？毛利率趋势？ 答：智能卡作为信息化基础设施的重要组成部分，广泛应用于金融支付、移动通信、公共交通、安全认证等多个领域。近年来，全球智能卡市场保持稳定增长，但受制于传统应用饱和，整体增长空间逐渐趋于有限。然而，随着工业互联网（IIoT）、AIoT、eSIM（贴片式）等新兴场景快速发展，智能卡产品在新领域中的应用需求不断增长，正在为行业注入新的增长动能。这些新应用构成了未来智能卡市场的核心增长动力。 公司智能卡业务的毛利率大约为 20%，在行业中处于中等水平。为应对挑战，公司正积极向超级 SIM 卡领域转型，依托其在功能集成、数据安全、增值服务等方面的优势，寻求突破传统智能卡业务瓶颈。超

	级 SIM 卡有望提升单卡附加值，开拓更广阔的市场空间，助力公司智能卡业务进入价值升级。 2、智能卡行业竞争格局，和同行业公司相比核心差异优势在哪？ 答：（1）全产业链整合能力 ——行业首家一站式服务商 公司是国内较早进入智能卡领域的企业，率先构建了从芯片应用研发、模块封测、智能卡研发、生产、销售及终端应用开发的端到端全流程体系，实现了行业内智能卡一站式交付能力的率先突破。不仅提升了产品一致性和交付效率，也显著提高了技术门槛与客户粘性，在智能卡行业中具备差异化竞争优势与更高的附加值空间。 （2）深耕海外市场 ——全球化运营能力突出 公司与国际头部企业如 THALES、IDEMIA 建立长期合作关系，产品外销占比超过 60%，并在印度新德里和印尼雅加达设有本地化研发生产基地，具有成熟的海外市场管理与交付经验，是国内智能卡企业中较早实现全球布局的公司。 （3）项目交付与本地服务能力强 公司拥有丰富的项目交付经验，2024 年起积极拓展与中国四大运营商的合作，成功中标中国联通智能卡采购项目。同时，公司前瞻性布局超级 SIM 卡应用，持续推动产品从通信工具向智能终端生态核心部件演进，开拓新兴场景，提升综合竞争力。 3、半导体业务切入的背景、技术路径优势与及未来规划？ 答：（1）切入背景 公司依托多年在专用芯片封装方面的技术积累，自 2019 年起逐步拓展至功率半导体封装材料领域，进入具备更高技术壁垒和增长潜力的产业链环节。自 2022 年开始形成规模出货，成为公司重点战略增长板块。 （2）技术路径与差异化优势 公司半导体封装业务聚焦于高性能封装材料的自主研发，核心产品包括：专用芯片引线框架、功率半导体引线框架和 SiC 和 IGBT 模块散热底板。公司技术路径聚焦于关键工艺与新材料的突破，通过持续创新，在导热性能、材料稳定性、封装效率与成本控制方面取得显著优
--	---

	势。 （3）未来发展规划 公司将以新能源汽车、数字能源、高端工业控制、第三代半导体等快速增长领域为导向，重点推动如下方向： ①加速散热底板等产品投产，推进 SiC 和 IGBT 模块封装材料解决方案落地； ②拓展头部功率模块客户及其工装配套链； ③深化国内外市场布局，提升半导体业务收入占比。 通过聚焦核心客户与关键应用场景，公司将进一步巩固技术壁垒，扩大市场份额，推动半导体业务成为新的业绩增长引擎。 4、研发投入占比及未来规划？ 答：公司将技术创新定位为核心竞争力，目前公司智能卡、半导体等业务的技术积累相对成熟，部分研发项目阶段性完成或转向应用端优化，公司长期结合成本效益分析对基础研发、核心技术的投入保持一定比例的投入。另研发费用中研发技术人员薪酬占有一定比重，近年来公司持续推出员工持股计划或股权激励项目，对技术人员薪酬采取“工资+股权激励”相结合的模式。公司研发投入的增减主要基于公司业务发展需求，未来根据市场反馈、技术进展及财务状况动态优化研发资源配置。 5、介绍一下公司海外市场，海外产能利用率情况？ 答：海外业务为公司核心战略支柱，收入占比长期超 60%，以东南亚、中东、非洲等新兴市场为重点，公司以“靠近客户设厂，快速反应需求，深化合作关系”为经营理念，主要通过印度新德里及印尼雅加达两大生产基地交付，缩短交付周期。现公司印度生产基地产能利用率达 70%-80%；印尼生产基地产能利用率达 80%-90%，目前海外两大生产基地通过本土化运营已形成稳健的研发生产能力。 6、大客户稳定性如何？是否有客户依赖风险？ 答：目前智能卡业务仍是公司的主要收入来源，智能卡行业特性决定了客户集中度相对较高，通过签订长期的战略合作协议，公司与 THALES、IDEMIA 等全球知名智能卡系统公司保持长期友好合作关系。
--	--

	公司具备丰富的大规模项目交付经验和服务能力，2024 年起公司在国内积极争取与四大运营商长期合作，前五大客户收入占比已从 2023 年的 87.92%降至 2024 年的 77.75%。此外，公司积极拓展多元客户群，延伸半导体封装、数字与能源热管理、智慧安全等新业务，有效降低智能卡单一业务依赖。 7、液冷业务的竞争优势、量产节点、未来展望与持续性？ 答：（1）核心竞争优势 公司液冷散热产品采用自主研发的高性能制造工艺，在以下方面具备明显技术优势： ①结构一体化设计：提升散热效率与产品可靠性； ②优异的导热与耐压性能：满足高功耗 AI 服务器、高性能计算设备对散热系统的高标准需求； ③更低的制造成本与更高的生产效率：相比传统方案，具备良好的量产经济，技术成熟度与成本控制能力兼具，便于大规模推广。 （2）量产节点与商业化进展 目前，公司液冷产品已完成多轮内部技术验证，并通过部分服务器整机厂商的测试认证，产品正处于量产准备阶段。 未来，公司将根据客户需求与配套项目节奏，灵活推进商业落地。 （3）未来展望与持续性战略 随着 AI 服务器、高性能计算和数据中心等行业对散热系统的性能要求不断提升，液冷散热正成为主流趋势。根据行业发展趋势： ①单个液冷模块的价值量持续上升； ②系统级液冷解决方案将成为未来服务器整机厂商的关键竞争能力； 公司将围绕核心客户持续推进技术升级、产品定制化与应用扩展。公司将以“技术领先、快速响应和规模化交付能力”为抓手，力争在下一代高性能散热技术中形成稳定市场份额，推动液冷业务成为新的增长曲线。 8、智慧安全业务的应用场景与挑战？目前进展？ 答：公司依托于在数字信息安全领域多年行业沉淀，不断在智慧安全综合业务领域进行相关技术储备，产品主要聚焦于交通安全领域，具
--	---

	体包括与国内运营商合作开发的超级 SIM 卡通行业务、高铁安全防护栏以及智慧安检业务，产品可有效提升交通基础设施的安全管控水平和运营效率，同时提升旅客通行效率和出行体验。公司在该领域已具备一定的技术优势，目前取得应用场景内的多个应用专利。 当前智慧安全业务以市场推广工作为主，公共事务商务切入周期相对较长，商业模式尚在探索，后续业务发展中如涉及需披露的对外合作，公司将根据有关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。 9、目前公司新业务主要挑战与风险、未来机遇 答：（1）主要挑战与风险 ①技术更新与演进风险 半导体封装材料和液冷散热等新业务领域具有较高技术门槛，技术迭代快速。若公司未能及时掌握新材料、新工艺或关键环节的技术趋势，可能面临生产效率下降、产品竞争力弱化等风险。 当前，公司在多个核心结构件方面已构建自主知识产权与工艺壁垒，产品技术处于市场领先地位。公司持续通过技术储备与前瞻性研发布局，提升对行业变革的快速响应能力，确保技术优势的持续巩固。 ②市场开拓与客户导入风险 新业务面临新的市场生态和客户结构，市场开拓处于关键阶段。若行业需求波动或客户导入进展不及预期，可能影响新业务的规模化推进。 （2）未来机遇 AI、高性能计算、新能源等应用高速增长，对高效散热和封装材料的需求不断提升，公司液冷与封装材料产品具备结构创新和成本优势，有望在核心客户放量下实现快速成长； 半导体行业长期景气向上，特别是在第三代半导体（SiC、GaN）、车规级功率模块、先进封装等领域，国产化替代进程持续提速，叠加全球供应链区域重构，公司具备自主工艺与本地交付能力，在功率半导体封装及高导热散热基座方面拥有广阔的发展空间； 绿色计算与智能制造趋势驱动液冷等高能效散热方案渗透率快速提升，公司凭借高性能-性价比兼具的产品，具备抢占技术转型窗口期
--	--

	的战略优势；随着新产品通过头部客户验证并进入量产导入周期，公司有望借助龙头客户放量带动，迅速建立行业口碑与市场份额，打开新业务成长曲线。 10、公司智能卡芯片是自产还是代工？ 答：公司智能卡所需芯片主要为外购或客户提供；公司自产的专用芯片一部分用于公司产品，一部分对外销售。 11、公司相关生产基地分布？ 答：公司目前共 6 大生产基地，分别位于深圳、上海、宁波、印度、印尼以及惠州。主要包括智能卡、半导体、数字与能源热管理、智慧安全四大主营业务。 12、公司应收账款情况？ 答：公司应收账款账期主要为月结 30 天或 60 天，公司目前客户主要为全球行业内领先的头部企业，基于客户行业地位稳固和支付能力强劲，公司应收款周转良好、回款周期稳定。 13、公司在液冷业务方面是否与华为有合作？ 答：目前公司尚未与华为在液冷业务领域建立合作关系。若未来相关业务涉及与华为的合作，公司将严格遵循保密协议约定及客户合规要求，严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规要求履行信息披露义务。 14、计划通过收并购方式？并购的具体方向和要求？ 答：公司坚持稳健经营策略，在发展上，公司不一味追求速度和规模，更注重稳健和长效。公司也密切关注产业链上下游优质标的，对行业内并购机会保持持续关注，公司将在充分评估风险和收益的前提下，结合行情变化及公司发展需求谨慎决策并适时考虑。 15、公司取得国内某知名 GPU 制造商的 S 级代理权的优势？合作规模？ 答：公司依托于在数字信息安全领域多年行业沉淀，积累了丰富的行业资源和客户合作经验，符合厂商资质要求，代理业务与现有智能卡、半导体业务存在协同作用，未来将围绕人工智能计算能力需求延伸服务，具体合作规模需根据市场需求动态情况推进。
--	---

风险提示	公司提醒新业务新产品开发过程中存在一定的技术风险、市场风险和应用验证周期风险，上述内容如涉及对行业的预测、公司发展战略规划等相关信息，不视作公司或公司管理层对行业、公司发展的承诺与保证，公司将严格按照有关法律法规的要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
附件清单 (如有)	无
日期	2025-5-29